

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions –
Part 8: Measurement of radiated emissions – IC stripline method**

**Circuits intégrés – Mesure des émissions électromagnétiques –
Partie 8: Mesure des émissions rayonnées – Méthode de la ligne TEM à plaques
(stripline) pour circuit intégré**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.200

ISBN 978-2-8322-6932-9

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	6
4 General	7
5 Test conditions	7
5.1 General.....	7
5.2 Supply voltage	7
5.3 Frequency range.....	7
6 Test equipment.....	8
6.1 General.....	8
6.2 RF measuring instrument	8
6.3 Preamplifier	8
6.4 IC stripline	8
6.5 50 Ω termination	8
7 Test set-up	8
7.1 General.....	8
7.2 Test configuration	9
7.3 EMC test board (PCB)	9
8 Test procedure	9
8.1 General.....	9
8.2 Ambient conditions.....	9
8.3 Operational check.....	10
8.4 Verification of IC stripline RF characteristic.....	10
8.5 Test technique	10
9 Test report.....	11
9.1 General.....	11
9.2 Measurement conditions	11
10 IC Emissions reference levels.....	11
Annex A (normative) IC stripline description.....	12
A.1 General.....	12
A.2 Characteristic impedance of stripline arrangements	13
A.3 Conversion for different active conductor heights	14
A.4 Example for IC stripline arrangement	14
Annex B (informative) Specification of emission levels.....	15
B.1 Scope	15
B.2 General.....	15
B.3 Specification of emission levels	15
B.4 Presentation of results	15
Bibliography.....	17
Figure 1 – IC stripline test set-up	9
Figure A.1 – Cross-section view of an example of an unshielded IC stripline	12
Figure A.2 – Cross-section view of an example of an IC stripline with housing	12
Figure A.3 – Example of IC stripline with housing	14

Figure B.1 – Emission characterization levels 16

Table A.1 – Maximum DUT dimensions for 6,7 mm IC stripline open version..... 13

Table A.2 – Maximum DUT dimensions for 6,7 mm IC stripline closed version 13

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS – MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS –

Part 8: Measurement of radiated emissions – IC stripline method

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 61967-8 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices. It is an International Standard.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2011. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) frequency range of 150 kHz to 3 GHz was deleted from the scope;
- b) extension of upper usable frequency to 6 GHz or higher as long as the defined requirements are fulfilled.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft	Report on voting
47A/1152/FDIS	47A/1153/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of all parts of the IEC 61967 series, under the general title *Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions* can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The "colour inside" logo on the cover page of this document indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTEGRATED CIRCUITS – MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS –

Part 8: Measurement of radiated emissions – IC stripline method

1 Scope

This part of IEC 61967 defines a method for measuring the electromagnetic radiated emission from an integrated circuit (IC) using an IC stripline. The IC being evaluated is mounted on an EMC test board (PCB) between the active conductor and the ground plane of the IC stripline arrangement.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-131, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 131: Circuit theory*

IEC 60050-161, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

IEC 61967-1, *Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions – Part 1: General conditions and definitions*

IEC 61000-4-20, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	20
1 Domaine d'application	22
2 Références normatives	22
3 Termes et définitions	22
4 Généralités	23
5 Conditions d'essai	23
5.1 Généralités	23
5.2 Tension d'alimentation	23
5.3 Plage de fréquences	24
6 Appareillage d'essai	24
6.1 Généralités	24
6.2 Appareil de mesure RF	24
6.3 Préamplificateur	24
6.4 Stripline pour CI	24
6.5 Terminaison de 50 Ω	25
7 Montage d'essai	25
7.1 Généralités	25
7.2 Configuration d'essai	25
7.3 Carte d'essai CEM (carte à circuit imprimé)	25
8 Procédure d'essai	26
8.1 Généralités	26
8.2 Conditions ambiantes	26
8.3 Vérification opérationnelle	26
8.4 Vérification des caractéristiques RF de la stripline pour CI	26
8.5 Technique d'essai	27
9 Rapport d'essai	27
9.1 Généralités	27
9.2 Conditions de mesure	27
10 Niveaux de référence des émissions du CI	27
Annexe A (normative) Description de la stripline pour CI	28
A.1 Généralités	28
A.2 Impédance caractéristique des conceptions de stripline	30
A.3 Conversion pour différentes hauteurs de conducteurs actifs	30
A.4 Exemple de conception d'une stripline pour CI	31
Annexe B (informative) Spécification des niveaux d'émission	32
B.1 Domaine d'application	32
B.2 Généralités	32
B.3 Spécification des niveaux d'émission	32
B.4 Présentation des résultats	32
Bibliographie	34
Figure 1 – Montage d'essai de la stripline pour CI	25
Figure A.1 – Vue en coupe d'un exemple de stripline pour CI non blindée	28
Figure A.2 – Vue en coupe d'un exemple de stripline pour CI comportant une enceinte	29
Figure A.3 – Exemple de stripline pour CI avec enceinte	31

Figure B.1 – Niveaux de caractérisation des émissions..... 33

Tableau A.1 – Dimensions maximales du DUT pour la version ouverte de la stripline
pour CI de 6,7 mm 29

Tableau A.2 – Dimensions maximales du DUT pour la version fermée de la stripline
pour CI de 6,7 mm 29

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTÉGRÉS – MESURE DES ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Partie 8: Mesure des émissions rayonnées – Méthode de la ligne TEM à plaques (stripline) pour circuit intégré

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L'IEC 61967-8 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés, du comité d'études 47 de l'IEC: Dispositifs à semiconducteurs. Il s'agit d'une norme internationale.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2011. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) la plage de fréquences de 150 kHz à 3 GHz a été retirée du domaine d'application;
- b) la fréquence utile supérieure est étendue à 6 GHz ou plus dans la mesure où les exigences définies sont remplies.

Le texte de la présente Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet	Rapport de vote
47A/1152/FDIS	47A/1153/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à son approbation.

La langue employée pour l'élaboration de la présente Norme internationale est l'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61967, publiées sous le titre général *Circuits intégrés – Mesure des émissions électromagnétiques*, se trouve sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

CIRCUITS INTÉGRÉS – MESURE DES ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Partie 8: Mesure des émissions rayonnées – Méthode de la ligne TEM à plaques (stripline) pour circuit intégré

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61967 définit une méthode de mesure des émissions électromagnétiques rayonnées d'un circuit intégré (CI) à l'aide d'une ligne TEM à plaques (stripline) pour circuit intégré. Le CI à évaluer est monté sur une carte d'essai CEM (carte à circuit imprimé) entre le conducteur actif et le plan de masse du dispositif de la stripline pour CI.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-131, *Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 131: Théorie des circuits*

IEC 60050-161, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique*

IEC 61967-1, *Circuits intégrés – Mesure des émissions électromagnétiques – Partie 1: Conditions générales et définitions*

IEC 61000-4-20, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-20: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'émission et d'immunité dans les guides d'onde TEM*